

## Infineon Technologies Eckdaten

Firmensitz:	München
Regionale Niederlassungen:	Nord-, Mittel-, Südamerika: San Jose, Kalifornien Asien-Pazifik: Singapur Japan: Tokio
Umsatz im Geschäftsjahr 2002: (30. September 2002)	5,21 Milliarden Euro
Mitarbeiter (September 2002):	Weltweit etwa 30.400
Marktposition 2002:	Weltweit Rang 6 unter den Halbleiterherstellern (nach Umsatz; Quelle: iSupply; Status 03/2003)
Aktivitäten:	Sichere mobile Lösungen (Nr. 1 im Chipkartensegment; unter den Top-3 Herstellern von GSM-ICs)  Drahtgebundene Kommunikation (Nr. 1 bei ISDN, VDSL und bei 40 Gbit/s ICs für optische Netzwerke)  Automobil- und Industrieelektronik (Nr. 2 im Automobilbereich weltweit; Nr. 1 in Europa)  Speicherbausteine (Nr. 1 in 300-Millimeter-Technologie, Nr. 3 im DRAM-Markt)

Fertigung: Acht Wafer-Produktionsstätten (Frontend-Fabs), u.a. modernste DRAM-Fertigung auf drei Kontinenten (Europa, USA, Asien)  
14 Produktionsstätten für Montage und Test (Backend)

Entwicklung: 27 Forschungs- und Entwicklungszentren für markt- und kundenorientierte Entwicklung in zehn Ländern

F&E-Aufwendungen im Geschäftsjahr 2002: über 1 Milliarde Euro (20 Prozent des Umsatzes)

Strategische Partnerschaften: UMC (Technologieentwicklung für die Herstellung von Logikprodukten; Fertigungs-JV in Singapur)  
Toshiba (Technologieentwicklung)  
AMD und DuPont Photomasks (Joint-Venture zur Entwicklung von lithographischen Masken der nächsten Generation)  
IBM (Technologieentwicklung, Fertigungs-JV in Frankreich)  
Winbond (Lizenzierung von Speichertechnologien, Lieferabkommen)  
SMIC (Lizenzierung von Speichertechnologien, Lieferabkommen)  
Nanya (Technologieentwicklung, Fertigungs-JV in Taiwan)

Börsenkürzel: Unter IFX als DAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse und der New York Stock Exchange notiert

Weitere Informationen unter [www.infineon.com](http://www.infineon.com)